



2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年4月24日
上場取引所 東

上場会社名 新光電気工業株式会社
コード番号 6967 URL <https://www.shinko.co.jp>
代表者 (役職名) 代表取締役社長
問合せ先責任者 (役職名) 社長室長
定時株主総会開催予定日 未定
有価証券報告書提出予定日 未定
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(氏名)倉嶋 進
(氏名)清野 貴博 TEL 026-283-1000
配当支払開始予定日 ー

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期の連結業績(2024年4月1日～2025年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期	215,022	2.4	25,354	2.2	25,125	△7.8	17,875	△3.9
2024年3月期	209,972	△26.7	24,810	△67.7	27,257	△65.4	18,609	△65.8

(注) 包括利益 2025年3月期 18,406百万円 (△10.9%) 2024年3月期 20,657百万円 (△63.1%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2025年3月期	132.30	ー	6.5	6.4	11.8
2024年3月期	137.73	ー	7.2	7.0	11.8

(参考) 持分法投資損益 2025年3月期 ー百万円 2024年3月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年3月期	397,136	283,381	71.4	2,097.30
2024年3月期	393,750	264,977	67.3	1,961.09

(参考) 自己資本 2025年3月期 283,381百万円 2024年3月期 264,977百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年3月期	48,260	△47,630	△156	82,853
2024年3月期	45,464	△73,273	△6,886	82,475

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2024年3月期	ー	25.00	ー	0.00	25.00	3,377	18.2	1.3
2025年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00	ー	ー	ー

(注) 2025年4月15日に公表いたしました「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の
手続を経て、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定であることから、2026年3月期の配当予想は記載しておりませ
ん。

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

2025年4月15日に公表いたしました「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の手
続を経て、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定であることから、2026年3月期の業績予想は記載しておりません。

※ 注記事項

(1)期中における連結範囲の重要な変更:無

(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :有
- ② ①以外の会計方針の変更 :無
- ③ 会計上の見積りの変更 :無
- ④ 修正再表示 :無

(注)詳細は、添付資料15ページ「4. 連結財務諸表および主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」をご覧ください。

(3)発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期	135,171,942株	2024年3月期	135,171,942株
② 期末自己株式数	2025年3月期	54,920株	2024年3月期	54,462株
③ 期中平均株式数	2025年3月期	135,117,376株	2024年3月期	135,114,166株

(参考)個別業績の概要

1. 2025年3月期の個別業績(2024年4月1日～2025年3月31日)

(1)個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2025年3月期	207,623	2.6	24,049	1.3	25,643	△8.5	18,627	△4.4
2024年3月期	202,350	△26.8	23,735	△67.8	28,014	△64.4	19,480	△64.5

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期	137.86	—
2024年3月期	144.18	—

(2)個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
2025年3月期	393,661	278,893	70.8	2,064.09
2024年3月期	388,261	260,164	67.0	1,925.47

(参考)自己資本 2025年3月期 278,893百万円 2024年3月期 260,164百万円

※ 決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

2025年4月15日に公表いたしました「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の
手続を経て、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定であることから、2026年3月期の業績予想は記載しておりませ
ん。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	4
(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当	5
2. 経営方針	6
(1) 経営の基本方針	6
(2) 中長期的な経営戦略	6
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	7
4. 連結財務諸表および主な注記	8
(1) 連結貸借対照表	8
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	10
連結損益計算書	10
連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	12
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)	15
(会計方針の変更)	16
(追加情報)	16
(セグメント情報)	18
(1株当たり情報)	21
(重要な後発事象)	21
参考資料	23

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

① 当期の経営成績

当連結会計年度の経済環境は、日本におきましては、雇用・所得環境の改善や個人消費の持ち直しなどにより景気は緩やかな回復傾向が継続した一方で、エネルギー・食料品価格等の高騰や円安の影響などにより物価上昇が進展しました。海外におきましては、米国では、個人消費や企業の設備投資などを背景に景気は底堅く推移し、中国では、不動産市場の停滞や内需の低迷などにより景気は低調な状況が継続しました。また、ロシア・ウクライナ紛争の長期化や中東地域の情勢混迷等に加え、米国新政権による関税をはじめとする通商政策等の見直しにより、世界経済の先行きに不確実性がさらに高まる状況となりました。

半導体業界につきましては、AI向けの需要拡大が継続するとともに、AI向けの設備投資を中心に半導体製造装置市場は堅調に推移した一方で、汎用サーバー、自動車、産業機器向け等は低調のまま推移し、在庫調整長期化の影響を受けるなど、需要動向の二極化がより鮮明となり、半導体業界全体の本格的な回復には至らない厳しい市場環境が継続しました。

このような環境下において、当社グループにおきましては、パソコン向けの競争激化の影響を受けたほか、汎用サーバー向けの需要が引き続き低調に推移し、自動車向けの在庫調整が長期化するなど、半導体市況回復の遅れの影響を大きく受けました。こうした厳しい市場環境の下、収益確保をはかるべく受注獲得および生産性向上に努めるとともに、コストダウン等に注力しました。設備投資につきましては、市場環境をふまえ、計画の一部見直しを行ったものの、半導体市場の中長期的な拡大や当社製品の今後の需要増加を見据え、引き続き重点的に経営資源を投下しました。フリップチップタイプパッケージは、顧客基盤拡充をはかるべく積極的な販売活動を展開するとともに、新たな生産拠点である千曲工場（長野県千曲市）については、さらなる微細化、多層化、大型化のニーズに対応し、高品質・高生産性・省人化を実現する最先端の工場を目指し、量産体制整備を推進しました。半導体製造装置の基幹部品であるセラミック静電チャックは、AI向けをはじめとする先端半導体の設備投資拡大等に対応すべく、高性能品の生産強化に注力しました。IC組立は、AI搭載機種をはじめとするハイエンドスマートフォン向け需要等を着実に取り込むべく、生産体制整備等を実施しました。半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板については、生産能力増強をはかるべく、新井工場（新潟県妙高市）において新棟建設を進めました。

それらの結果、半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、AI向け半導体等の設備投資拡大を背景とした需要増加などにより売上が増加し、IC組立はハイエンドスマートフォン向け等の需要拡大などにより、売上が増加しました。一方、フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れやパソコン向けの競争激化の影響などにより減収となりました。これらにより、当連結会計年度の売上高は2,150億22百万円（前連結会計年度比2.4%増）となりました。利益面につきましては、フリップチップタイプパッケージなどの減収等により、経常利益は251億25百万円（前連結会計年度比7.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は178億75百万円（同3.9%減）となりました。

なお、2025年3月19日付「JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」において公表しましたとおり、JICC-04株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けは、2025年2月18日から開始され、2025年3月18日をもって終了し、応募された株式の数の合計が買付予定数の下限（22,491,200株）以上となり、本公開買付けは成立しております。今後、一連の手続が実施され、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定です。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

プラスチックパッケージ

フリップチップタイプパッケージは、サーバー向けの需要回復の遅れやパソコン向けの競争激化の影響などにより減収となりました。プラスチックBGA基板は先端メモリ向け等の在庫調整などの影響を受け減収となりました。IC組立はハイエンドスマートフォン向け等の需要拡大などにより売上が増加しました。

これらの結果、当セグメントの売上高は1,226億58百万円（前連結会計年度比4.0%減）、経常利益はフリップチップタイプパッケージなどの減収等により53億60百万円（同54.7%減）となりました。

メタルパッケージ

半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、AI向け半導体等の設備投資拡大を背景とした需要増加などにより売上が増加し、CPU向けヒートスプレッダーは、サーバー向けの受注増加により増収となりました。ガラス端子は光学機器向けの売上が前年並みとなりました。リードフレームは自動車向け等の在庫調整の影響を受けたものの、為替相場における円安の進行などにより売上は前年並みとなりました。

これらの結果、当セグメントの売上高は841億6百万円（前連結会計年度比13.8%増）、経常利益は202億49百万円（同25.5%増）となりました。

なお、上記のセグメント別の売上高は外部顧客への売上高であり、経常利益はセグメント間取引調整前のものです。

② 今後の見通し

今後の世界経済は、通商分野をはじめとする米国における大幅な政策変更が、世界全体の経済情勢に大きな影響を及ぼすことが想定されるとともに、中国経済の減速や地政学リスクの継続等により、先行きは極めて不透明な状況が続くものと予想されます。日本におきましても、賃金上昇等により個人消費は回復基調で推移することが期待される一方、米国の新たな通商政策の影響や物価高による消費意欲減退等も懸念されるなど、先行きを見通すことが困難な状況にあります。

半導体業界におきましては、今後、AIを活用したサービスがさらに浸透し、AIを搭載するパソコン、スマートフォンの需要が増加するなど、引き続きAI関連が半導体需要を牽引する一方で、自動車向けや産業機器向けは在庫調整の継続が見込まれるなど、市況環境の二極化が継続することが想定されます。また、米中対立の激化等に伴い半導体業界全体のサプライチェーンの構造変化も懸念されるなど、従来に増して複雑化する市場動向に留意を要する予断を許さない状況が続くものと見込まれます。一方、DX（Digital Transformation）の進展等による社会・経済のデジタル化や、持続可能な成長の実現を目指す脱炭素社会への移行と情報通信量の大幅な増加による電力消費の抑制を両立するGX（Green Transformation）の実現を支えるキーテクノロジーとして、今後、さらに半導体の重要性が高まるとともに、高度化・多様化・複雑化する市場のニーズや需要動向の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制やサプライチェーンの構築を要することが見込まれます。また、半導体のさらなる高機能化・多機能化のニーズへの対応をはかるうえで、半導体製造におけるパッケージングプロセスの重要性が高まっており、特に、当社が主な事業内容とする半導体パッケージは、半導体の一層の高機能化・高速化と省電力対応に欠くことのできない中核製品として半導体産業におけるニーズがさらに高まることが想定されま

す。

このような環境下にあつて、当社グループといたしましては、マーケティング機能の強化や製販一体の取り組みを推進し、顧客基盤の一層の拡充に努め、また、積極的な受注活動を展開することなどにより当社製品の販売拡大をはかるとともに、全社において生産性向上・効率化、徹底したコストダウン等の取り組みを強化してまいります。また、これまで高い成長が見込まれる市場向けに継続的・重点的に経営資源の投下をはかってまいりましたが、市場環境をふまえ、必要により時期・内容を適切に判断のうえ、引き続き当社製品の中長期的な市場拡大を見据えた設備投資を展開してまいります。半導体の一層の高機能化・高速化や省電力化等のニーズに対応するフリップチップタイプパッケージについては、千曲工場（長野県千曲市）における量産体制整備を推進するとともに、半導体メモリーの高速化・大容量化に対応するプラスチックBGA基板については、新井工場（新潟県妙高市）において新棟建設等による生産体制強化を実施してまいります。加えて、中長期的に大きな成長が見込まれるHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）市場のニーズに対応する当社開発の「i-THOP[®]」をはじめとする先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケージの量産体制整備計画を推進するとともに、情報通信量の大幅な増加に対応する次世代情報通信基盤の構築における基幹デバイスとして、消費電力の飛躍的な低減とデータ処理の超高速化を実現する「光電融合デバイス」の開発に注力するなど、これまで培ってまいりました最先端の半導体実装技術をもとに、市場ニーズを先取りした新商品・新技術の確立・量産化に取り組み、持続的な成長・発展を目指してまいります。

さらに、厳しい事業環境において、収益基盤の一層の強化をはかるべく、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる生産体制の確立に努めてまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあつて、常にお客様のニーズを起点とし、機能・性能、コスト、品質すべてにおいてお客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいり所存であります。

なお、2025年4月15日に公表いたしました「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の経路を経て、当社株式は2025年6月6日に上場廃止となる予定であることから、2026年3月期の業績予想は記載しておりません。

（2）当期の財政状態の概況

① 資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末における財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が33億86百万円増加し3,971億36百万円となりました。負債は150億17百万円減少し1,137億55百万円となりました。純資産は184億3百万円増加し2,833億81百万円となりました。この結果、自己資本比率は71.4%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は482億60百万円（前連結会計年度比27億95百万円増）となりました。また、投資活動の結果使用した資金は476億30百万円（同256億43百万円減）となりました。財務活動の結果使用した資金は1億56百万円（同67億30百万円減）となりました。

これらの活動の結果に為替換算差額を加味した当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億78百万円増加し828億53百万円となりました。

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

2023年12月12日に公表いたしました「JICC-04株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」に記載のJICC-04株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けが行われました。つきましては、2025年3月期は配当を行いません。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は、中長期的な成長が見込まれるエレクトロニクス産業にあって、半導体の進化を支え、半導体の優れた機能を人々の生活へと繋ぐテクノロジーをもとに、世界中の人々の暮らしを豊かに彩るものづくりに取り組むとともに、お客様のニーズを起点とする優れた製品を開発・製造・販売することによって、「限りなき発展」を目指しています。

また、このような「技術力」、「発展性」とともに、「国際性」、「温かさ」を企業理念として掲げ、世界各国のお客様と取引を行い、各地に拠点を展開するグローバル企業として国際社会での共存共栄を念頭に置き、多様な人材の能力を結集し、社員一人ひとりの成長を実現できる環境づくりに努め、「人と地球環境への温かさ」を考えた経営姿勢で事業を推進することにより、社会の健全な発展に寄与し、輝かしい未来の創造に貢献することを目指しています。

(2) 中長期的な経営戦略

超高速大容量通信を実現する情報通信基盤の進化やAI、IoTの急速な利用拡大等を背景とするDX (Digital Transformation) の進展が、経済や社会の仕組みに大きな変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されるとともに、戦略的な観点からもその重要性がさらに高まる状況にあります。また、自動運転やコネクテッドカー等の技術開発が加速する自動車市場や多様な分野での活用が期待されるロボティクスなど、半導体は、今後も市場を拡大することが見込まれています。加えて、脱炭素社会への移行に向けた取り組みを加速し、GX (Green Transformation) の実現に不可欠なテクノロジーの進化を支えるキーデバイスとして、半導体のニーズはさらに高度化・多様化することが想定されます。

一方で、高機能化・高速化等の技術革新および絶えず変化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が、さらに一段と激化することが予想されます。

このような産業にあって、当社グループは、インターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発とものづくりの革新に努め、お客様にとって、機能・性能、コスト、品質すべてにおいて価値の高い製品・サービスをご提供することにより、お客様の成功を支え、自らの発展・成長を目指してまいります。加えて、市場ニーズや変化を先取りした新商品や新技術の開発に注力するとともに、変化の激しい需要環境にも柔軟かつ効率的に対応できる生産体制の構築に取り組んでまいります。また、キャッシュ・フローを重視し、常に利益を創出できる強固な経営基盤の確立に努め、かつコーポレート・ガバナンスの充実をはかるとともに、以下の項目に重点をおいた経営戦略を展開してまいります。

① 成長分野への重点的展開

今後、市場拡大の一方で、高性能化・高機能化のニーズを背景にテクノロジーの高度化が見込まれる半導体産業にあって、お客様のニーズを的確にとらえ、それを実現する開発力・製造力の充実・革新に努めるとともに、創業以来培ってきたコアテクノロジーをもとに、高い成長が見込まれる分野に重点的に経営資源を投下し、強い競争力を有する製品の開発・量産化を推進することにより、さらなる成長を目指してまいります。

また、常に新たな市場機会を追求し、高い将来性が見込まれる市場や製品分野の探求に注力することを通じて、持続可能な成長を果たしてまいります。

② 強固な生産体制の構築

市場環境の変化が激しく、熾烈な競争が繰り返される半導体産業にあつて、市場の変化に速やかに対応する強固な生産体制を構築することが企業存続・発展の条件ととらえ、全社において、製造プロセスの革新と最適化を強力に推進いたします。また、開発・設計から生産に至るすべての段階において品質を造り込み、優れた製品を安定的に供給することができる体制を確立することにより、収益基盤の一層の強化をはかってまいります。

③ SHINKO Wayの推進

社会における新光電気グループの存在意義、大切にすべき価値観、および社員が実践すべき行動指針、守るべき行動規範を示した「SHINKO Way」の実践を通じ、株主の皆様のご期待に応え、お客様、お取引先、地域社会の皆様や社員をはじめとするステークホルダーの方々との調和をはかるとともに、多様なサステナビリティ課題に対する活動の推進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。なかでも、地球環境における喫緊の課題である気候変動への対応を最重要な課題と位置づけ、カーボンニュートラルの早期実現をはかるべく、グループ全体における取り組みを加速してまいります。

なお、当社株式については、JICキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者による公開買付けが2025年2月18日から2025年3月18日までを公開買付期間として実施され、その結果、本公開買付けが成立しております。今後、公開買付者は、当社を完全子会社化するための一連の手続を実施し、当社株式は上場廃止となる予定です。

当社は、市況環境変化の激しい半導体産業にあつて、当社製品・テクノロジーの中長期的な市場拡大の可能性を的確に捉え、機動的かつ柔軟な経営判断を行うことが重要との認識に基づき、成長市場向けの設備投資・技術開発を重点的に展開する当社の事業方針を基本的に支持し、政府系ファンドとして短期的な業績変動に動じず、中長期的な観点で企業価値の向上に資する取組みを推進していくことが可能なJICキャピタル株式会社を中心に構成される公開買付者を新たなパートナーとして、これまで以上の意思決定のスピードアップをはかり、当社事業推進において根幹となる人的資本の拡充などの施策を進めるとともに、当社がこれまで培った多様な半導体実装技術をもとに、先端領域の技術開発や光電融合技術等の次世代半導体技術の開発・事業化に注力してまいります。

こうした取り組みを通じて当社のさらなる事業成長および企業価値の向上を果たすことにより、当社株式の再上場を目指してまいります。

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、検討を進めていく方針であります。

4. 連結財務諸表および主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	82,807	83,140
受取手形	240	152
売掛金	56,475	58,243
商品及び製品	8,583	5,432
仕掛品	14,245	18,291
原材料及び貯蔵品	7,963	7,643
その他	14,150	7,908
貸倒引当金	△6	△6
流動資産合計	184,459	180,804
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	78,118	75,799
機械装置及び運搬具（純額）	38,317	33,379
工具、器具及び備品（純額）	3,814	3,824
土地	10,255	10,096
建設仮勘定	71,478	86,220
有形固定資産合計	201,984	209,319
無形固定資産	1,175	1,206
投資その他の資産		
投資有価証券	53	55
退職給付に係る資産	2,524	2,708
繰延税金資産	2,459	1,792
その他	1,102	1,258
貸倒引当金	△8	△8
投資その他の資産合計	6,131	5,805
固定資産合計	209,291	216,332
資産合計	393,750	397,136

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	28,164	29,378
短期借入金	30,000	30,000
未払金	17,306	5,179
未払法人税等	3,366	3,784
未払費用	10,053	9,334
契約負債	35,912	27,782
その他	2,143	7,590
流動負債合計	126,946	113,050
固定負債		
退職給付に係る負債	1,101	236
その他	725	468
固定負債合計	1,826	705
負債合計	128,773	113,755
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,222	24,222
利益剰余金	215,736	233,612
自己株式	△61	△64
株主資本合計	264,119	281,992
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4	5
繰延ヘッジ損益	△103	—
為替換算調整勘定	513	290
退職給付に係る調整累計額	443	1,092
その他の包括利益累計額合計	857	1,388
純資産合計	264,977	283,381
負債純資産合計	393,750	397,136

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
売上高	209,972	215,022
売上原価	171,070	175,151
売上総利益	38,902	39,871
販売費及び一般管理費	14,091	14,517
営業利益	24,810	25,354
営業外収益		
受取利息	686	594
受取補償金	789	959
為替差益	600	—
雑収入	454	282
営業外収益合計	2,530	1,836
営業外費用		
支払利息	67	168
為替差損	—	1,889
雑支出	16	8
営業外費用合計	83	2,066
経常利益	27,257	25,125
特別利益		
補助金収入	784	278
特別利益合計	784	278
特別損失		
固定資産除却損	842	279
固定資産圧縮損	784	278
公開買付関連費用	500	—
特別損失合計	2,126	557
税金等調整前当期純利益	25,915	24,845
法人税、住民税及び事業税	6,750	6,779
法人税等調整額	555	189
法人税等合計	7,305	6,969
当期純利益	18,609	17,875
親会社株主に帰属する当期純利益	18,609	17,875

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益	18,609	17,875
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	1
繰延ヘッジ損益	△117	103
為替換算調整勘定	1,125	△222
退職給付に係る調整額	1,037	649
その他の包括利益合計	2,048	530
包括利益	20,657	18,406
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	20,657	18,406
非支配株主に係る包括利益	—	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,173	203,882	△74	252,205
当期変動額					
剰余金の配当			△6,755		△6,755
親会社株主に帰属する当期純利益			18,609		18,609
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		48		12	61
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	48	11,854	12	11,914
当期末残高	24,223	24,222	215,736	△61	264,119

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	1	14	△612	△594	△1,190	251,014
当期変動額						
剰余金の配当						△6,755
親会社株主に帰属する当期純利益						18,609
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						61
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2	△117	1,125	1,037	2,048	2,048
当期変動額合計	2	△117	1,125	1,037	2,048	13,963
当期末残高	4	△103	513	443	857	264,977

当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,223	24,222	215,736	△61	264,119
当期変動額					
親会社株主に帰属する当期純利益			17,875		17,875
自己株式の取得				△2	△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	17,875	△2	17,872
当期末残高	24,223	24,222	233,612	△64	281,992

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	4	△103	513	443	857	264,977
当期変動額						
親会社株主に帰属する当期純利益						17,875
自己株式の取得						△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1	103	△222	649	530	530
当期変動額合計	1	103	△222	649	530	18,403
当期末残高	5	—	290	1,092	1,388	283,381

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	25,915	24,845
減価償却費	27,639	26,578
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△171	△257
受取利息及び受取配当金	△691	△599
支払利息	67	168
為替差損益 (△は益)	△478	10
補助金収入	△784	△278
有形固定資産除却損	842	279
固定資産圧縮損	784	278
公開買付関連費用	500	—
売上債権の増減額 (△は増加)	7,116	△1,827
棚卸資産の増減額 (△は増加)	4,528	△621
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,874	1,310
未払費用の増減額 (△は減少)	△261	△720
契約負債の増減額 (△は減少)	△5,623	△8,130
その他	△1,612	12,939
小計	59,644	53,975
利息及び配当金の受取額	695	600
利息の支払額	△65	△149
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△15,094	△6,344
補助金の受取額	784	178
公開買付関連費用の支払額	△500	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,464	48,260
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△875	△682
定期預金の払戻による収入	1,341	696
有形固定資産の取得による支出	△71,928	△46,384
無形固定資産の取得による支出	△503	△240
投資及び長期貸付金の増減額 (△は増加)	△822	△900
その他	△485	△119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,273	△47,630
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△6,755	—
その他	△130	△156
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,886	△156
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,578	△95
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△33,116	378
現金及び現金同等物の期首残高	115,592	82,475
現金及び現金同等物の期末残高	82,475	82,853

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 8社

※主要会社名:

SHINKO ELECTRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.、KOREA SHINKO MICROELECTRONICS CO., LTD.、
SHINKO ELECTRIC AMERICA, INC.

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社 SHINKO MICROELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日

12月末 1社

3月末 7社

12月末日決算会社は、12月末決算により連結しております。

連結決算日の不一致による差異に重要なものがある場合には連結上調整を行うこととしております。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの・・・・・・時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等・・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブ

時価法を採用しております。

③棚卸資産

総平均法および先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法によっております。ただし、当社および国内連結子会社については、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な収益および費用の計上基準

当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としております。このような製品の販売については、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識しております。また、製品の販売について、得意先から部品を仕入、加工を行った上で加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売する取引については、売上高と売上原価を純額表示しております。なお、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益および費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源となる取引等に応じて、損益、株主資本およびその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本またはその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

（公開買付けの結果ならびに主要株主およびその他の関係会社の異動）

当社は、2025年3月19日に、JICC-04株式会社（以下「公開買付者」という。）より、公開買付者が2025年2月18日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）が2025年3月18日をもって終了し、本公開買付けの結果について報告を受けました。

また、本公開買付けの結果、2025年3月26日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社の主要株主およびその他の関係会社に異動が発生いたしました。

なお、公開買付者は、当社を完全子会社化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」という。）を実施することを予定しており、本スクイーズアウト手続を実施した場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は所定の手続を経て上場廃止となります。

1. 本公開買付けの結果

本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立いたしました。

2. 主要株主およびその他の関係会社の異動について

(1) 異動年月日

2025年3月26日（本公開買付けの決済の開始日）

(2) 異動が生じる経緯

当社は、2025年3月19日に、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式59,281,400株の応募があり、応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限（22,491,200株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われ、2025年3月26日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合（注）が20%以上となるため、公開買付者は、新たに当社の主要株主およびその他の関係会社に該当することになりました。これに伴い、公開買付者の親会社であるJIC PE共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に保有することになるため、当社のその他の関係会社に該当することとなります。

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、2024年12月31日現在の当社の発行済株式総数（135,171,942株）から、同日現在当社が所有する自己株式数（54,550株）を控除した株式数（135,117,392株）に係る議決権の数（1,351,173個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。（以下同じ。）

(3) 異動する株主の概要

① 新たに主要株主およびその他の関係会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	JICC-04株式会社
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 板橋 理
(4) 事業内容	①会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 ②その他前号に掲げる事業に付帯または関連する事業
(5) 資本金	100,000円
(6) 設立年月日	2023年9月29日
(7) 大株主および持株比率	JIC PE共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合 69%
	大日本印刷株式会社 15%
	JIC PEファンド1号投資事業有限責任組合 9%
	三井化学株式会社 5%
	八十二-JICC投資事業有限責任組合 2%
(8) 当社と公開買付者の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

② 新たにその他の関係会社に該当することとなる者の概要

(1) 名称	JIC PE共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号	
(3) 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合	
(4) 業務執行組合員の概要	名称	JICキャピタル株式会社
	所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役 池内 省五
	事業内容	エクイティ投資およびエクイティ投資に付随するコンサルティング
	資本金	20,000,000円
(5) 当社と当該者の関係	当社と当該者の関係	該当事項はありません。
	当社と業務執行組合員の関係	該当事項はありません。

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数および議決権所有割合および所有株式数

① JICC-04株式会社

	属性	議決権の数（総株主の議決権の数に対する割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算所有分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	主要株主およびその他の関係会社	592,814個 (43.87%、 59,281,400株)	—	592,814個 (43.87%、 59,281,400株)	第2位

② JIC PE共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合

	属性	議決権の数（総株主の議決権の数に対する割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算所有分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	その他の関係会社 (当社株式の間接保有)	—	592,814個 (43.87%、 59,281,400株)	592,814個 (43.87%、 59,281,400株)	—

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、半導体パッケージの開発・製造・販売を主な事業内容としており、製品の種類や特性によって分類された事業区分に基づき、国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、当該事業区分を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「プラスチックパッケージ」および「メタルパッケージ」の2つを報告セグメントとしております。

「プラスチックパッケージ」は、プラスチック・ラミネート・パッケージ等の製造・販売およびICの組立・販売を行っております。「メタルパッケージ」は、半導体用リードフレーム、半導体用ガラス端子およびセラミック静電チャック等の製造・販売を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の売上高は、主に第三者間取引価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
I C リードフレーム	—	33,971	33,971	4,908	38,880	—	38,880
I C パッケージ	127,752	5,518	133,270	285	133,556	—	133,556
気密部品	—	34,388	34,388	3,143	37,531	—	37,531
その他	—	—	—	3	3	—	3
顧客との契約から生じ る収益	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	127,752	73,878	201,631	8,341	209,972	—	209,972
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	430	430	3,611	4,041	△4,041	—
計	127,752	74,308	202,061	11,952	214,014	△4,041	209,972
セグメント利益	11,828	16,133	27,962	1,099	29,061	△1,803	27,257
その他の項目							
減価償却費	20,507	6,369	26,877	761	27,639	—	27,639
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	6,391	2,680	9,071	551	9,623	54,573	64,197

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。

2. セグメント利益の調整額△1,803百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額54,573百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。

5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2 (注) 4	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
	プラスチック パッケージ	メタル パッケージ	計				
売上高							
一時点で移転される財	122,658	84,106	206,765	8,257	215,022	—	215,022
一定の期間にわたり移 転される財	—	—	—	—	—	—	—
I C リードフレーム	—	34,171	34,171	4,215	38,386	—	38,386
I C パッケージ	122,658	6,745	129,404	223	129,628	—	129,628
気密部品	—	43,189	43,189	3,815	47,005	—	47,005
その他	—	—	—	2	2	—	2
顧客との契約から生じ る収益	122,658	84,106	206,765	8,257	215,022	—	215,022
その他の収益	—	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	122,658	84,106	206,765	8,257	215,022	—	215,022
セグメント間の内部 売上高または振替高	—	631	631	3,476	4,107	△4,107	—
計	122,658	84,738	207,397	11,733	219,130	△4,107	215,022
セグメント利益	5,360	20,249	25,610	1,427	27,037	△1,912	25,125
その他の項目							
減価償却費	19,901	6,207	26,108	469	26,578	—	26,578
有形固定資産および 無形固定資産の増加額	11,994	2,532	14,527	207	14,734	4,901	19,636

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に連結子会社の事業によるものであります。
2. セグメント利益の調整額△1,912百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4. 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額4,901百万円は、主に全社共通部門における投資額であります。
5. セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

(1 株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	1,961.09円	2,097.30円
1株当たり当期純利益金額	137.73円	132.30円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	18,609	17,875
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額(百万円)	18,609	17,875
期中平均株式数(千株)	135,114	135,117

(重要な後発事象)

(株式併合、単元株式数の定め廃止および定款の一部変更)

当社は、2025年4月15日開催の取締役会(以下「本取締役会」という。)において、2025年5月20日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)を招集し、本臨時株主総会に、株式併合に関する議案ならびに、単元株式数の定め廃止および定款の一部変更に関する議案を付議することを決定いたしました。

1. 株式併合の目的

JICC-04株式会社(以下「公開買付者」という。)は、2025年2月18日から2025年3月18日までを公開買付期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」という。)を行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2025年3月26日をもって、当社の普通株式(以下「当社株式」という。)59,281,400株(所有割合(注):43.87%)を所有するに至りましたが、本公開買付けにおいて、当社株式の全て(但し、富士通株式会社(以下「富士通」という。))が所有する当社株式および当社が所有する自己株式を除く。以下同じ。)を取得することができなかったことから、当社は、公開買付者からの要請を受け、本取締役会において、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の株主を公開買付者および富士通のみとすることを目的に、本臨時株主総会において、株式併合(以下「本株式併合」という。)に関する議案を付議することを決議いたしました。

(注)「所有割合」とは、2024年12月31日現在の当社の発行済株式総数(135,171,942株)から、同日現在当社が所有する自己株式数(54,550株)を控除した株式数(135,117,392株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいう。

2. 株式併合の日程

臨時株主総会基準日公告日	2025年3月17日(月)
臨時株主総会基準日	2025年3月31日(月)
取締役会決議日	2025年4月15日(火)
本臨時株主総会開催日	2025年5月20日(火)(予定)
整理銘柄指定日	2025年5月20日(火)(予定)
最終売買日	2025年6月5日(木)(予定)
上場廃止日	2025年6月6日(金)(予定)
本株式併合の効力発生日	2025年6月10日(火)(予定)

3. 株式併合の内容

(1) 併合する株式の種類

普通株式

(2) 併合比率

当社株式22,519,495株を1株に併合する予定

(3) 減少する発行済株式総数

135,116,966株

(4) 効力発生前における発行済株式総数
135,116,972株

(注) 効力発生前における発行済株式総数は、2024年12月31日現在の当社の発行済株式総数(135,171,942株)から、当社が本取締役会において消却を決議し、2025年6月9日付で消却される予定の2025年4月10日現在当社が所有する自己株式(54,970株)を除いた株式数です。

(5) 効力発生後における発行済株式総数
6株

(6) 効力発生日における発行可能株式総数
24株

(7) 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法ならびに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

本株式併合により、公開買付者および富士通以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられる。以下同じ。)に相当する当社株式を売却することによって得られる金銭を、株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却について、当社は、当社株式が2025年6月6日に上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられること、および本株式併合が、当社の株主を公開買付者のみとし、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場している当社株式を非公開化することを目的とする一連の取引の一環として行われるものであり、かかる目的との関係では公開買付者が端数相当株式の買受人となるのが整合的であることを踏まえ、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することを予定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である5,920円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

参考資料



2025年4月24日
新光電気工業株式会社

2025年3月期 連結および単独決算概要

〔連結〕

1. 業績等の概況

(単位：百万円)

	2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	2025年3月期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで)	増減率 (%)
売上高	209,972	215,022	2.4
営業利益	24,810	25,354	2.2
経常利益	27,257	25,125	△7.8
親会社株主に帰属する 当期純利益	18,609	17,875	△3.9
1株当たり当期純利益	137円73銭	132円30銭	
総資産	393,750	397,136	
純資産	264,977	283,381	
自己資本比率	67.3%	71.4%	
設備投資額*	63,693	19,395	
減価償却費*	27,435	26,370	
研究開発費	3,496	4,082	
為替レート(1米ドル)	143円	150円	

* 無形固定資産を除く

2. セグメント情報

(単位：百万円)

セグメント		2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		2025年3月期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで)		増減率 (%)
売上高 *1	プラスチックパッケージ	127,752	構成比(%) (60.8)	122,658	構成比(%) (57.1)	△4.0
	メタルパッケージ	73,878	(35.2)	84,106	(39.1)	13.8
	その他	8,341	(4.0)	8,257	(3.8)	△1.0
	合計	209,972	(100.0)	215,022	(100.0)	2.4
経常利益 *2	プラスチックパッケージ	11,828	利益率(%) (9.3)	5,360	利益率(%) (4.4)	△54.7
	メタルパッケージ	16,133	(21.8)	20,249	(24.1)	25.5
	その他 / 調整額	△704		△484		
	合計	27,257	(13.0)	25,125	(11.7)	△7.8

*1 外部顧客への売上高

*2 セグメント間取引調整前の経常利益

3. 部門別売上高

(単位：百万円)

部 門	2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		2025年3月期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで)		増減率 (%)
		構成比(%)		構成比(%)	
I C リードフレーム	38,880	(18.5)	38,386	(17.8)	△1.3
I C パッケージ	133,556	(63.6)	129,628	(60.3)	△2.9
気 密 部 品	37,531	(17.9)	47,005	(21.9)	25.2
そ の 他	3	(0.0)	2	(0.0)	△33.0
合 計	209,972	(100.0)	215,022	(100.0)	2.4

〔単 独〕

1. 業績等の概況

(単位：百万円)

	2024年3月期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)	2025年3月期 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで)	増減率 (%)
売 上 高	202,350	207,623	2.6
営 業 利 益	23,735	24,049	1.3
経 常 利 益	28,014	25,643	△8.5
当 期 純 利 益	19,480	18,627	△4.4
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	144円18銭	137円86銭	
総 資 産	388,261	393,661	
純 資 産	260,164	278,893	
自 己 資 本 比 率	67.0%	70.8%	
1 株 当 た り 配 当 金	25円	0円	